

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

家登精密工業股份有限公司



2025.07.04



Partner with **H.E.A.R.T.** , Grow with **P.A.S.S.I.ON.**

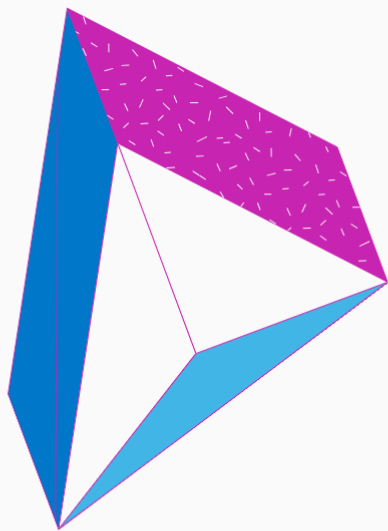
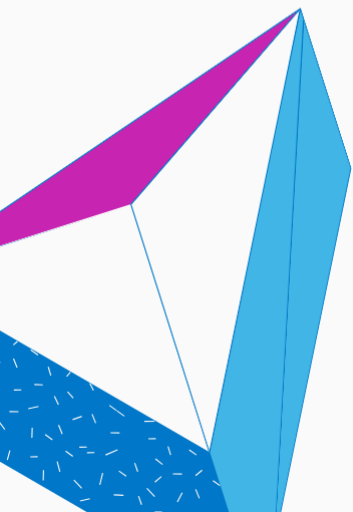
發言人：朱佳琳
電話：(02)2268-9141
郵件：Lynn.Chu@gudeng.com



本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊觀測站。

另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。

大綱



1 公司概况

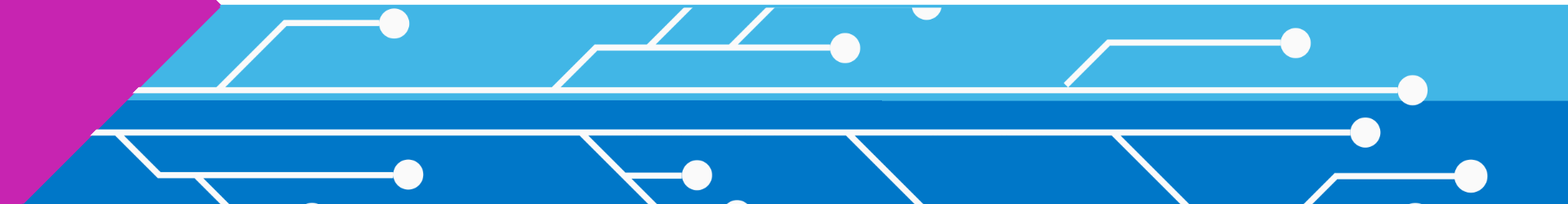
2 產品應用

3 營運成果

4 營運展望

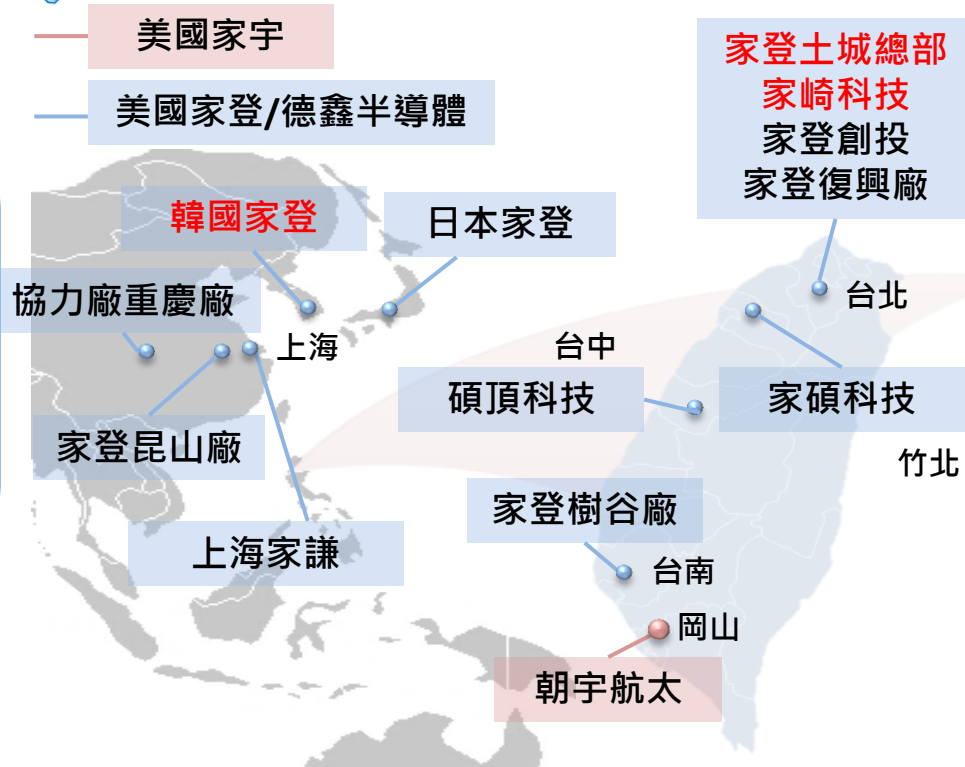


公司概況





家登-先進載具設備領航者



- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：1300 up
- 實收資本額：NT 960,392,390
- 集團**2021**營業額：NT **31.2** 億元
- 集團**2022**營業額：NT **44.9** 億元
- 集團**2023**營業額：NT **50.8** 億元
- 集團**2024**營業額：NT **65.5** 億元
- 集團**2025 5月**營業額：NT **28.7** 億元 (與去年同期成長14%)
- 主力產品：

半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 先進封裝傳載解決方案
- ④ 半導體機台設備

航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



家登集團旗下企業



大中華地區:

上海家謙

昆山廠
重慶協力廠

日韓地區:

日本家登

久留米廠

韓國家登

美國地區:

美國家登



家登精密:

- 光罩傳載解決方案
- 晶圓傳載解決方案
- 先進封裝傳載解決方案
- 半導體化學品相關產品及耗材

樹谷廠
復興廠
台中協力廠

花壇廠
龍福廠

家碩科技:

- 光罩盒充氣存儲設備
- 光罩清洗機

家崎科技:

- Cooling機台設備
- 半導體相關耗材

碩頂科技:

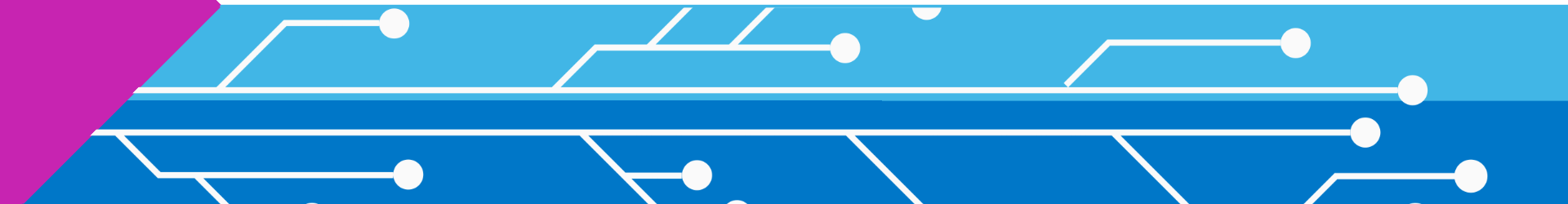
- 先進封裝傳載解決方案

家宇航太:

- 液壓控制缸體零件
- 傳輸管件零件
- 航太相關特殊製程



產品應用





半導體製程

- AI
- 航太
- 通訊
- 汽車
- 消費電子
- 國防

Mask shop

光罩盒

多層
光罩盒

Foundry-成熟製程

8 吋
晶圓盒

RSP
150

FOUP/
FOSB

- 8吋FAB
- 12吋成熟FAB

Foundry-先進製程

EUV
POD

Diffuser
FOUP

- 12吋先進FAB
- EUV製程

先進封裝

Wafer
Level

Panel
Level

- Chip on Wafer
- Chip on Panel





先進封裝技術-家登全系列解決方案

Foundry
(FOSB)

Chip On ...

Frame
Cassette

2023

Wafer with Frame

Chip on Wafer

2024

2025

Heavy Duty

Chip on Panel

2025



TOSB
Top Open Shipping Box

2024

Quarter Panel FOUP

2021

2025

243*241

300*300

¼ Panel product transport

On Substrate

410/450 Panel
Shipping Box

2025

Glass/CCL

Full Panel FOUP

2025

2023

2022

600*600

510*515

510*510

Panel processing transport

IC Tray FOUP

2025

2025

100kg
Tray FOUP

Tray FOUP

IC Tray

IC product transport

家登精密



High-NA

EUV pod Phase1

曝光機曝光效率增加

EUV pod Phase2



家登精密

微汙染防治

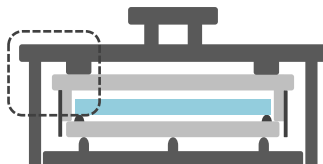


內盒摩擦痕

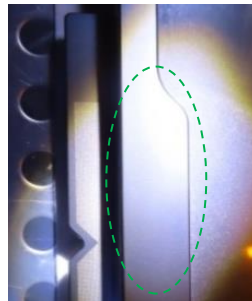


原設計

- 僅外盒設計垂直固定，因此有位移和微粒子疑慮



無摩擦痕

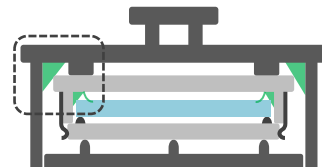
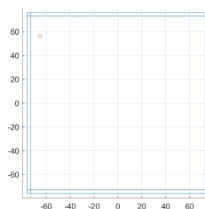


新設計

- 修改內外盒設計，新增固定位置，避免單一內外盒傳送時，因晃動產生位移及微粒子問題

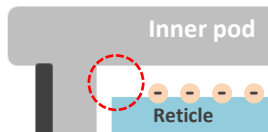
無微粒子

ASML傳送測試



殘餘電荷

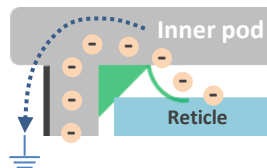
電荷殘餘



原設計

- 外盒移除後，電荷殘留於光罩上，產生光罩崩角、圖形炸裂等靜電相關疑慮

導出殘餘電荷



新設計

- 於內盒新增導電角，導出光罩上殘餘電荷，避免因靜電產生相關疑慮



High-NA EUV Pod



Gudeng Phase II Pod Qualification

Test	Test Description/ specification	Phase II Pod
Defectivity Shipping	Reticle FS QA → ≤ 1 adder ≥ 92 nm	1 F-S QA adder
	Reticle FS non QA → ≤ 1 adder ≥ 100 nm	1 F-S nQA adders
	Reticle BS → ≤ 22 adders ≥ 1000 nm	0 B-S adders
	Reticle vertical sides @ 8 corners aligned with EIP pins → no visible damage	No visible damage
Functionality	Load Port → No errors due to EUV pod	No errors
	RBI Functionality → No RBI defects due to pod reflections	No RBI defects
	Full Cycle → No errors due to EUV pod	No functionality error found
Defectivity 100X PRP	Reticle FS QA → 0 adders due to pod	0 adders in QA due to pod
	EIP contact points → 0 adders ≥ 25 μ m LSE and no damage to reticle coating	0 contact pt adders No visible damage
Defectivity RH cycle (2500)	Reticle FS QA → ≤ 1 adder ≥ 92 nm LSE Reticle FS nQA → ≤ 50 adder ≥ 100 nm LSE Reticle BS → ≤ 50 adder ≥ 1000 nm LSE EIP contact pts 0 adder ≥ 25 μ m LSE No damage to reticle coating	Skipped (PRDM will be re-defined)

● Pass

● In Progress

● Failed

ASML

Page 2
Confidential

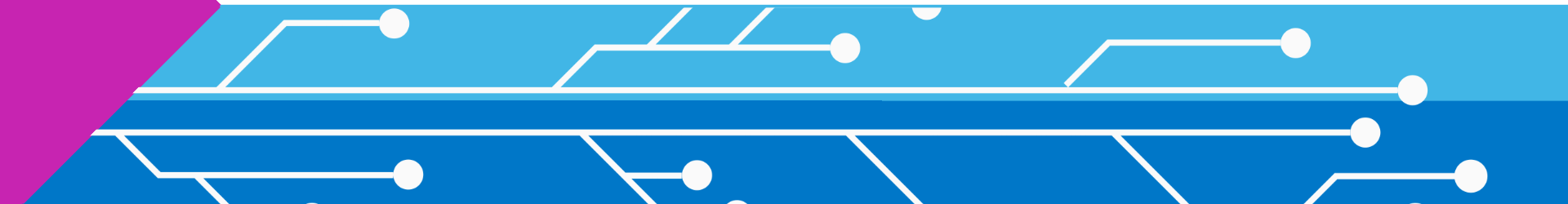
Copyright© 家登精密工業股份有限公司著作權所有

家登精密

2025/07/04



營運成果





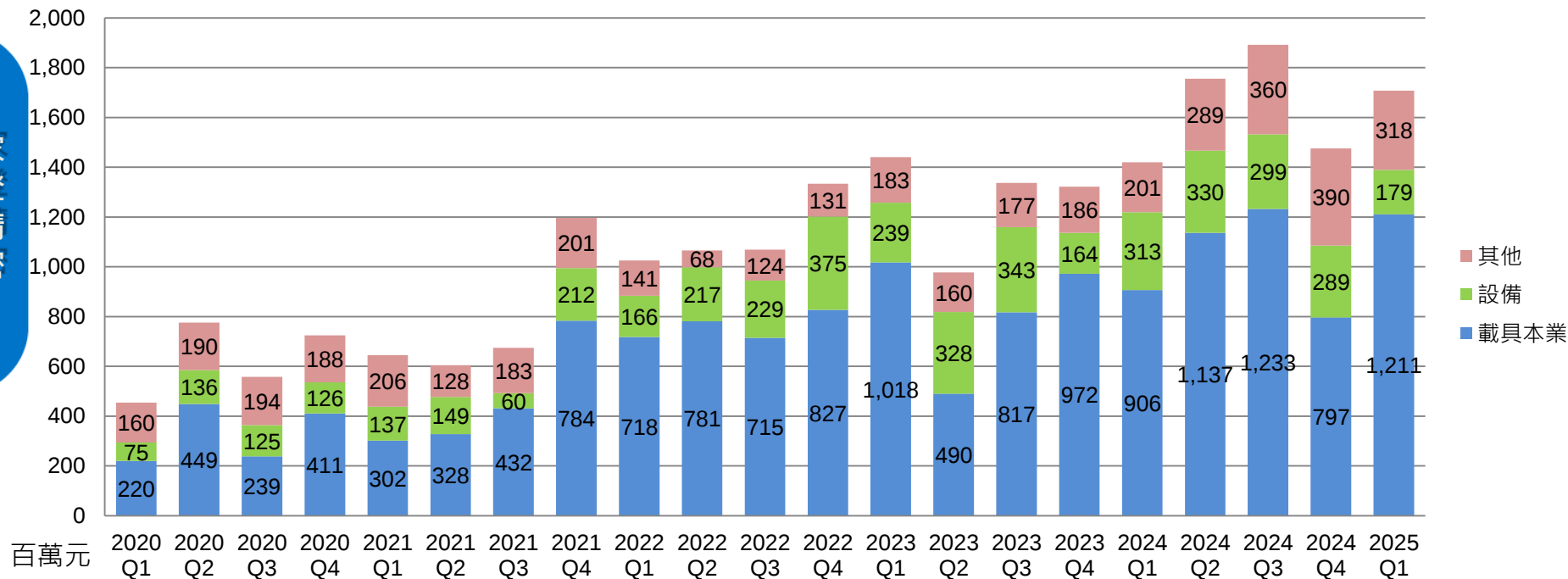
綜合損益表 YOY

	2025 Q1		2024 Q1	
營收	1,708,796	100%	1,420,424	100%
成本	961,150	56%	795,124	56%
毛利額	747,646	44%	625,300	44%
費用	445,567	26%	394,908	28%
淨利	302,079	18%	230,392	16%
營業外收入 及支出	(14,317)	(1)%	74,666	6%
稅前淨利	287,762	17%	305,058	22%
本期淨利	220,245	13%	235,824	17%
EPS	2.20		2.24	

新台幣千元

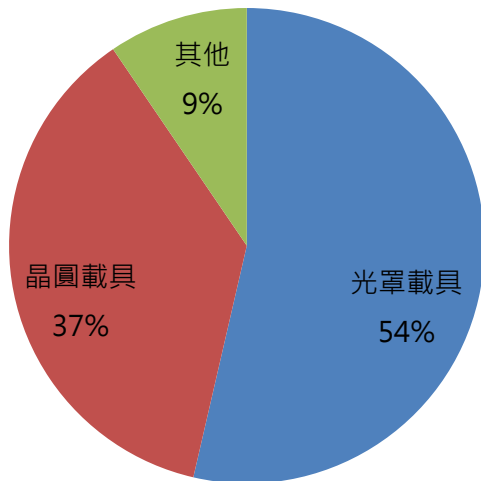


家登集團合併營收

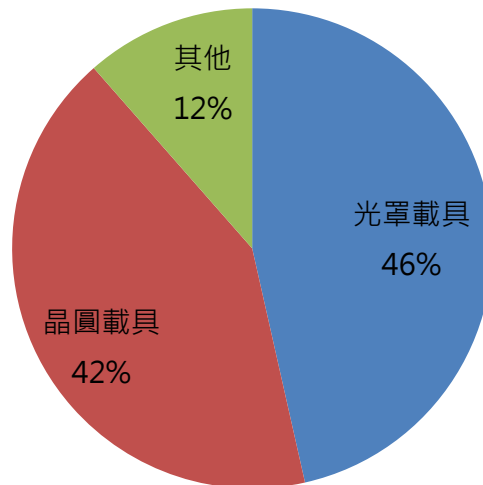




2024 Q1



2025 Q1

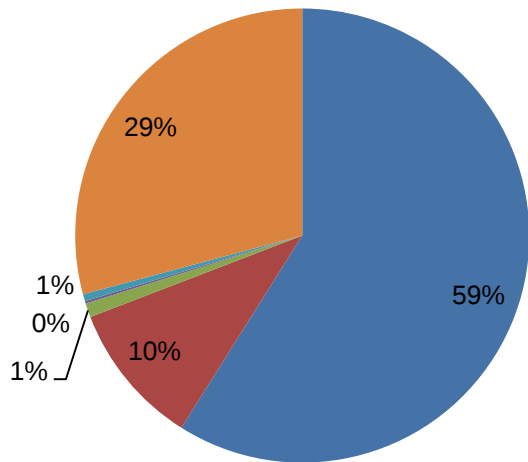




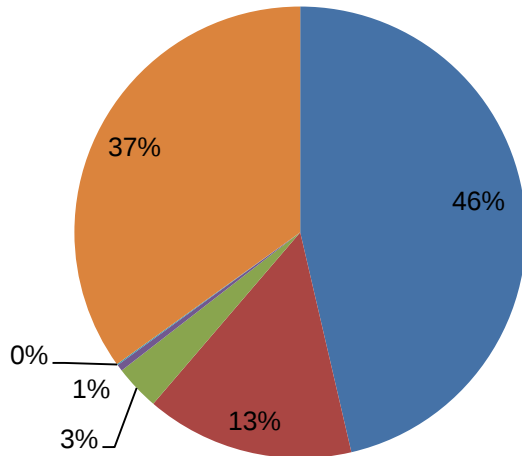
家登本業營收地區表現



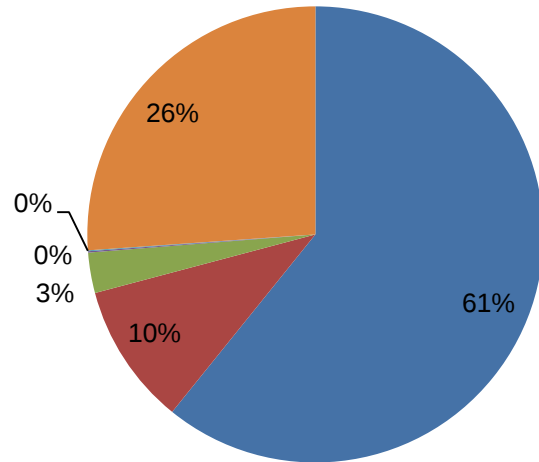
2023



2024



2025 5月



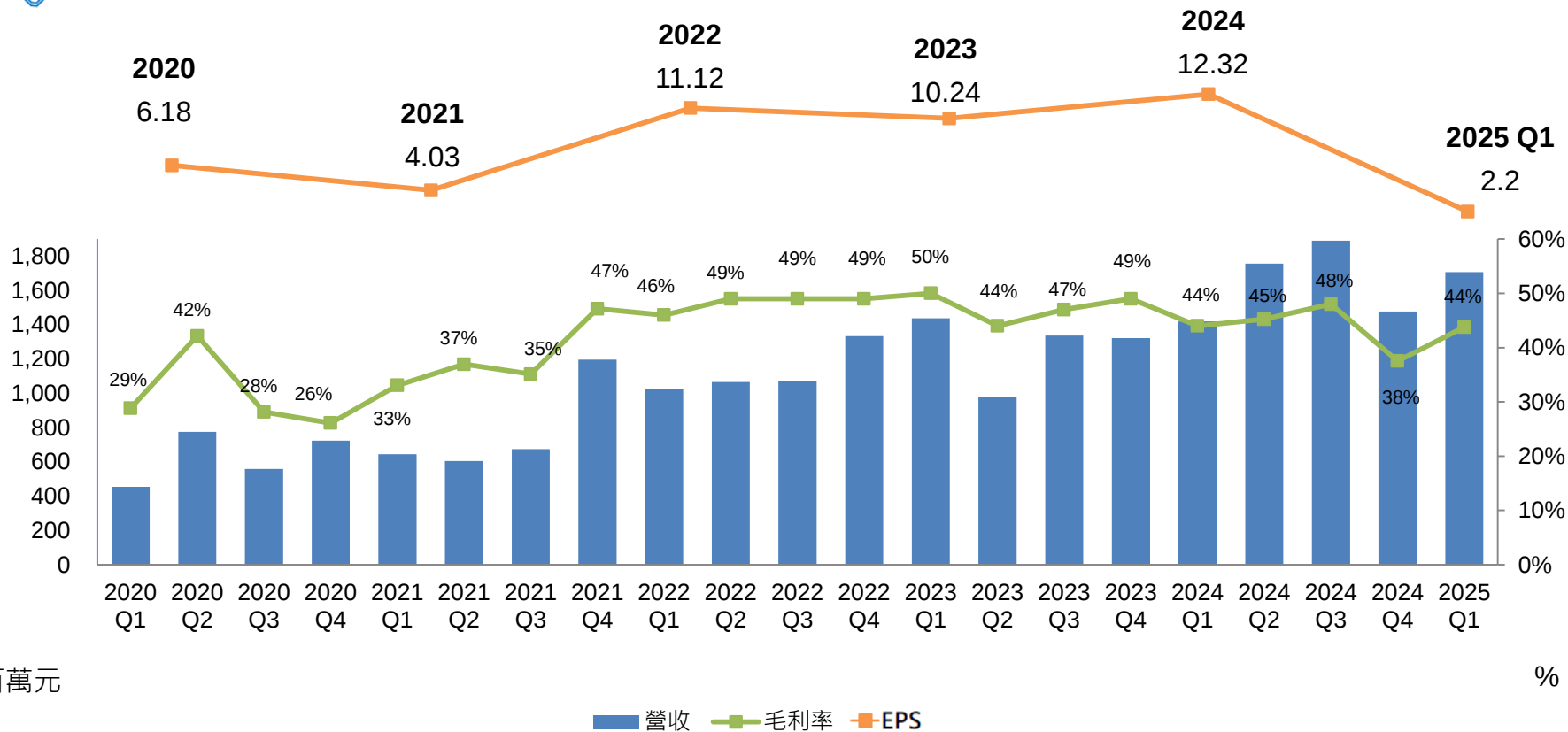
■ 台灣 ■ 美國 ■ 日韓 ■ 其他 ■ 歐洲 ■ 大中華



家登集團每季毛利

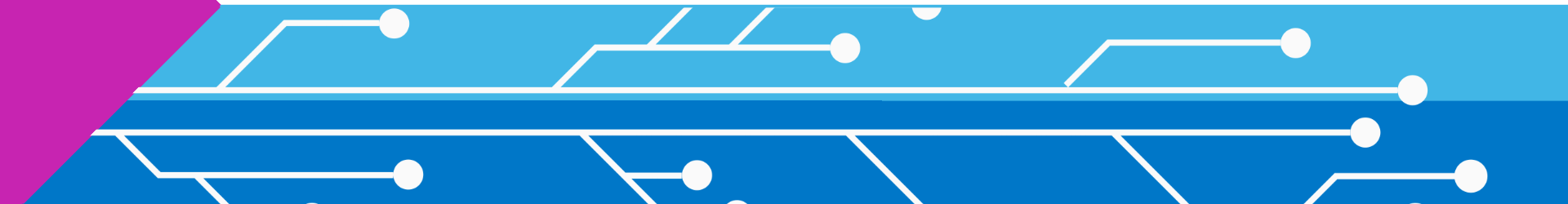


家登精密





營運展望





家登發展藍圖-五大亮點



家登精密



Gudong

「深耕關鍵客戶」
「開拓新客戶」
「發展新市場」
三大策略重點聚焦發展

「**協同創新Co-Creation**」
整合上中下游客戶、供應商
尋找優質併購標的
擴展集團事業體

2025 ~

EUV Pod

先進製程持續擴充，High-NA
EUV POD等相關需求量大



2025 ~

晶圓載具解決方案

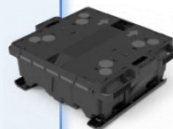
全系列晶圓載具全球市佔不斷攀
升，先進製程市占快速增加，成為
家登主力產品之一



2026~

先進封裝系列載具

完整先進封裝解決方案，持續
配合客戶驗證進度，成為主力
供應商



2026 ~

拓展新技術

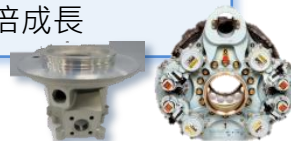
持續研發Cooling、化學桶等相
關新技術，拓展新市場



2026 ~

航太事業

航太營收正式挹注，不斷擴充客
戶群，挑戰營收翻倍成長





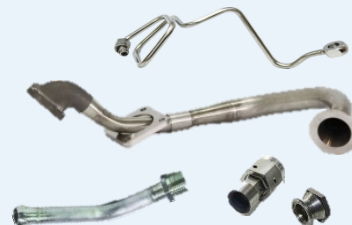
航太事業主力客戶



導管、逆止閥、緊固件
及相關加工零件，適用於
GE引擎件



提供各式管件及連接管
等，更於廠內進行化工處
理及特殊焊接工段



航太事業起源
「高進入障礙」
「高毛利市場」
「精密加工」



不僅提供板金、加工零件和管件接頭，更提供
塑膠射出產品



透過3~5軸車銑床加工技術，提供控制液壓零件，
如缸體、腔體、活塞等

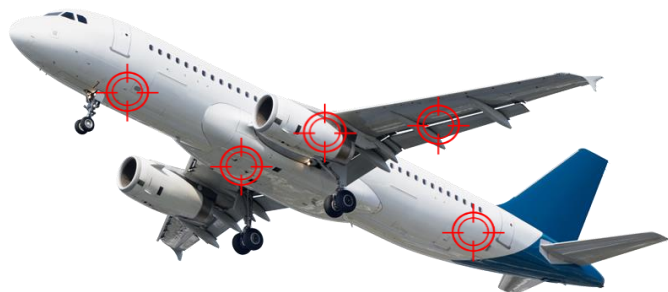




家登航太產品佈局



家登精密



液壓控制缸體&週邊
48% 市佔率



GE Aerospace

Honeywell

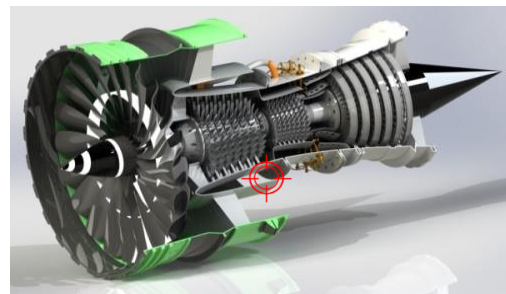
AEROSPACE



Pratt & Whitney

A United Technologies Company

傳輸燃油/冷卻液管&週邊
72% 市佔率





2025年航太事業展望



電控系統散熱 & 電系(塑膠)
37% 市佔率



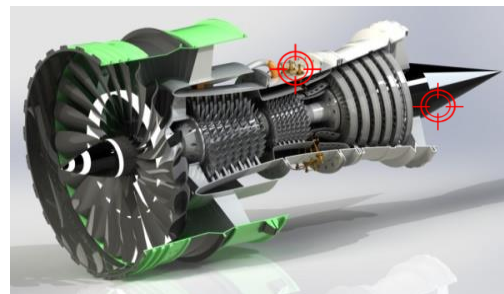
機艙內飾(塑膠)
36% 市佔率



燃油機噴油系統
91%市佔率



飛機煞車懸吊系統
63%市佔率



高溫液氣體排放系統
42% 市佔率





家登ESG實踐績效



榮獲天下永續公民獎 中堅企業 永續百強
榮獲TCSA台灣企業永續獎 企業永續報告 白金級



ESG 評等摘要

上市櫃ESG評等

A

經濟

11-30%

社會

11-30%

環境

31-50%

揭露

11-30%

單位營收碳排量至

2023年減少**33%**
(以2021年為基期)



單位營收用水量至
2023年減少**54%**
(2021年為基期)

單位營收廢棄物至2023年
減少**21%** (2021年為基期)

次料循環利用專案，回收**再製棧板、運輸箱、人體工學椅**

2023年員工平均年薪**21**個月

2023年提供**185**個優質工作機會



2023年投入**17**項社會公益行動，效益達**1,600萬元**

2023年人均薪資福利費用
832,000元



導入**ISO22301、ISO20400、ISO 27001**

永續報告書
第1類白金級

獲得品質領域最高榮譽
27th 國家品質獎

永續綜合績效獎
台灣100大永續典範企業獎



家登集團成長藍圖

營收成長

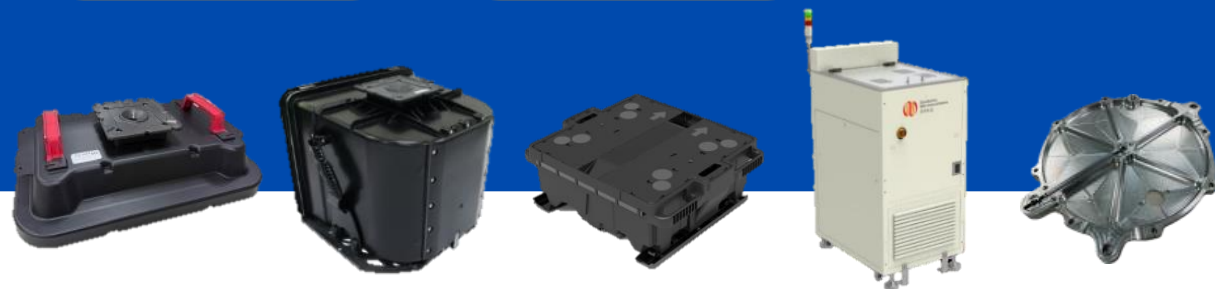
- 持續搶佔光罩及晶圓載具市場
- 聚焦先進製程，成為關鍵客戶主力供應商

擴充產能

- 積極擴充全球產能，就近服務全球大客戶
- 推進在台擴廠進度，備足新事業產能

聯盟合作

- 協同德鑫夥伴提供全球大戶一站式服務
- 整合聯盟夥伴資源持續擴充海外市場





Thank You
www.gudeng.com